

日立イオンミリング装置

IM4000PLUS

Hitachi Ion Milling System IM4000Plus

◎ 特長

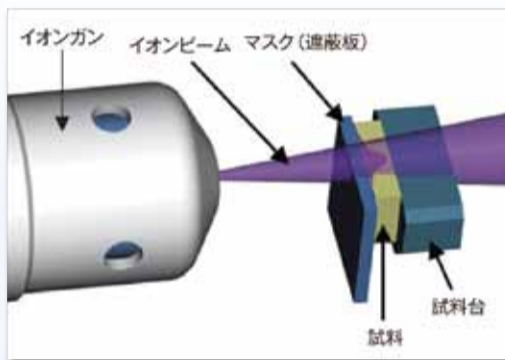
- 断面・平面ミリングに対応したハイブリッドタイプ
- 断面ミリングの高スループット化を実現
($> 500 \mu\text{m}/\text{h}$ at 6 kV^{*1})
- 平面ミリング(フラットミリング[®])による広領域加工を実現

*1 マスクエッジからSiを100 μm 突出させて1時間加工したときの最大深さ
フラットミリング[®]は、日本国内における日立ハイテクノロジーズの登録商標です。

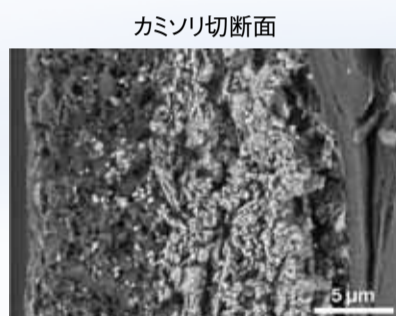


日立イオンミリング装置IM4000PLUS

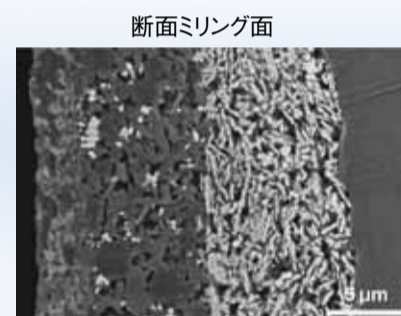
◎ 断面ミリング



断面ミリング加工模式図

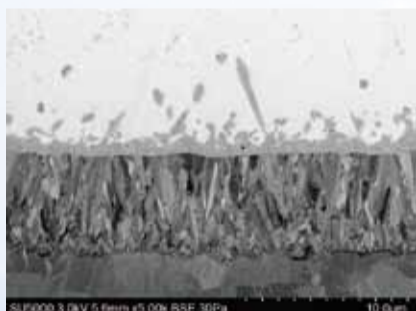


カミソリ切断面

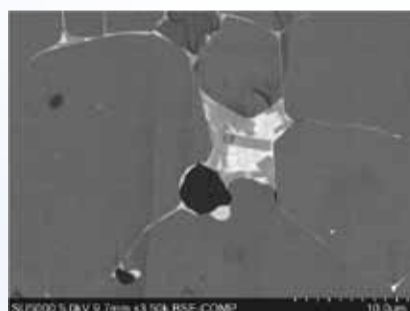


断面ミリング面

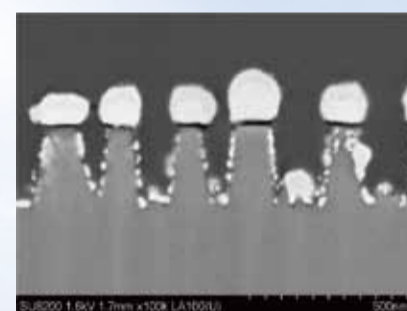
試料：感熱紙



試料：鉛フリーはんだ



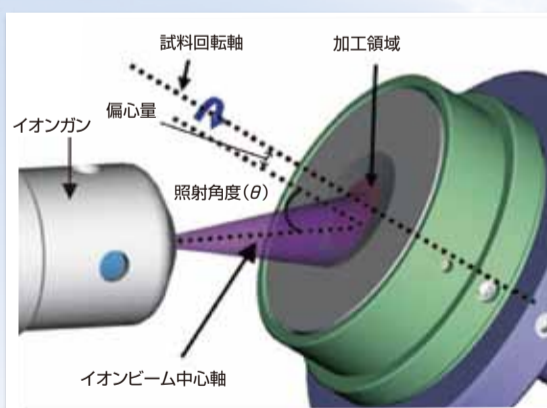
試料：Nd磁石



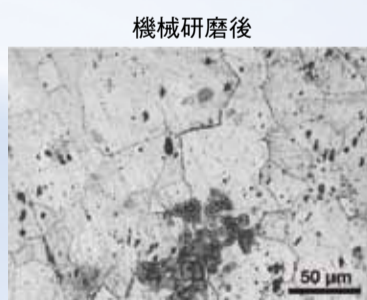
試料：ナノピラー

試料ご提供：東京工業大学 吉野 雅彦 教授

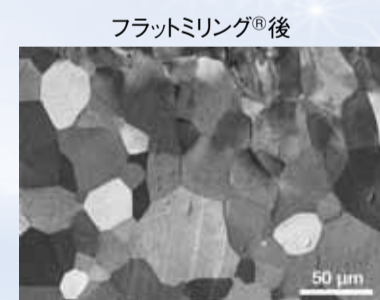
◎ フラットミリング[®]



フラットミリング[®]加工模式図

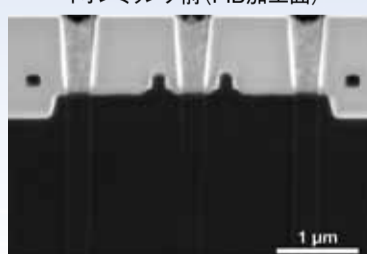


機械研磨後

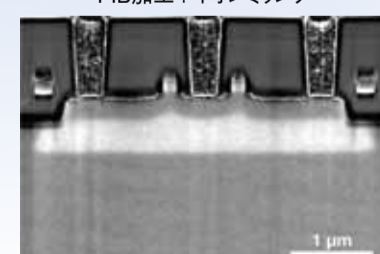


フラットミリング[®]後

試料：鋼材



イオンミリング前 (FIB加工面)



FIB加工+イオンミリング

試料：SRAM